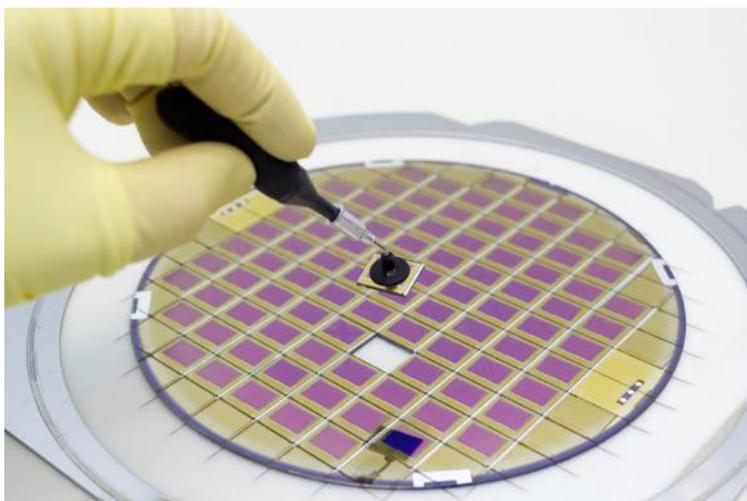
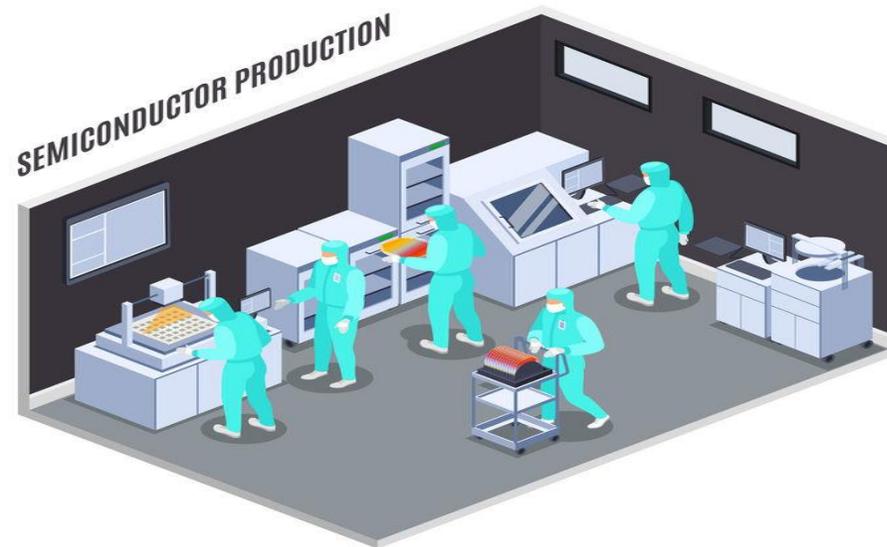


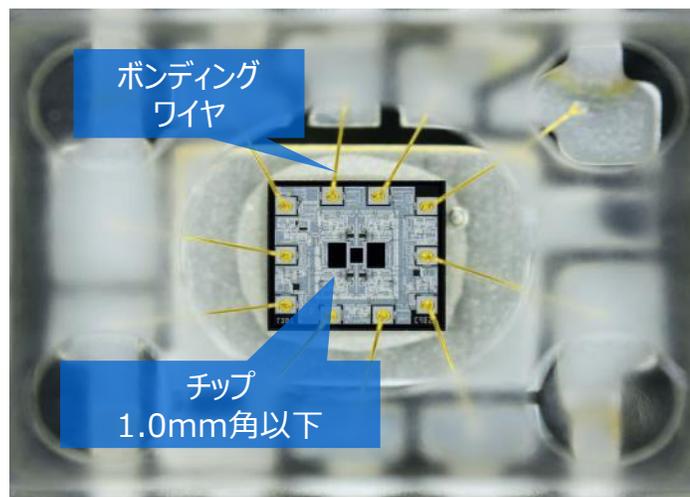
設計開発（東芝向けディスクリート製品） 2：量産立上/アセンブリー工程

開発した半導体ウェハは、個片化でペレットとした後にモールドパッケージに実装封止し製品化します。

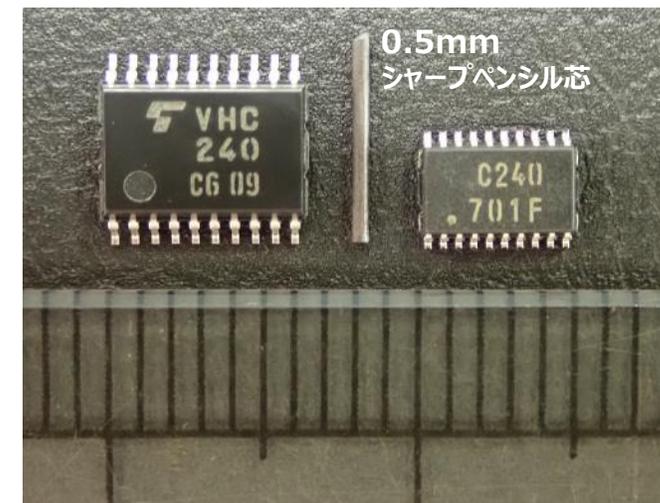
そのアセンブリー工程での量産立上、生産技術を担っています。



半導体ウェハとチップ（イメージ）



IC製品の中身（イメージ）



IC製品外観とサイズイメージ

TOSHIBA

* 本資料に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。